

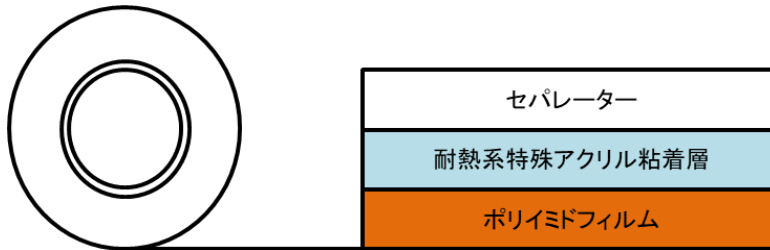
耐熱イミド基材マスキング・部材固定用テープ

# 178HT

- 特徴**
- ①半田耐熱性ポリイミドフィルムを基材にした耐熱テープ
  - ②高温下でも優れた接着力
  - ③糊残り性に優れる為、再剥離用途で使用可能
  - ④シロキサンフリー

**用途** 電子部品や半導体チップ部材固定

**構成**



**基本特性**

製品名	基材厚み ( $\mu\text{m}$ )	粘着層 ( $\mu\text{m}$ )	粘着力(N/25mm)		
			SUS(25 $^{\circ}\text{C}$ )	SUS(200 $^{\circ}\text{C}$ )	SUS(250 $^{\circ}\text{C}$ )
178HT	25	15	2.5	2.5	2.8

引張速度 300mm/min

引張角度 180度

測定温度 23 $^{\circ}\text{C}$

貼り合わせた後、1時間後の測定値

※SUSは金メッキしたSUSを使用

**ご使用上の注意**

技術資料は全て共同技研化学(株)の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成されております。  
但し、製品特性は環境や被着体によって大きく変わることがあります。  
したがってこれらの特性データにつきましては参考値であり、保証値ではありません。  
ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。

改訂: 2023年10月20日

共同技研化学株式会社  
〒359-0011  
埼玉県所沢市南永井940番地  
TEL 04-2944-5151  
Mail: info-k@kgk-tape.co.jp  
URL: <https://www.kgk-tape.co.jp/>